

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-156376

(43) 公開日 平成7年(1995)6月20日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

B 4 1 J 2/01  
2/045  
2/055

B 4 1 J 3/ 04 1 0 1 Z  
1 0 3 A

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平5-302060

(22) 出願日 平成5年(1993)12月1日

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者 中野 智昭

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

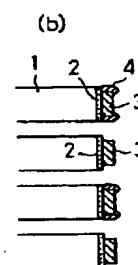
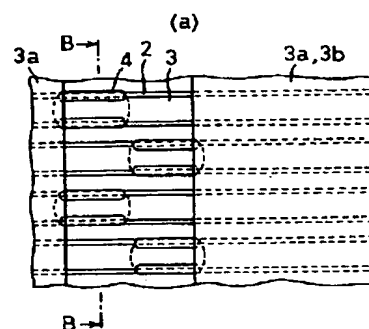
(74) 代理人 弁理士 高野 明近

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッド及びその製造方法及びその製造方法に使用する導体パタン

(57) 【要約】

【目的】 圧電素子の複数の電極部材と導体パタンとの接合を一括接合するときに、半田がはみ出してショートしないようする。

【構成】 所定ピッチに分断されている圧電素子1の各々に外部電極2が配列され、この外部電極2に該外部電極2に対応した導体パタン3を半田接合する。その際、半田4がはみ出しても、隣接する電極からの半田のはみ出し同志がと接触しないように、隣接する半田接合面を互いにずらしておく。



(2)

特開平7-156376

1

2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、インク液を収容する複数のインク流路と、各インク流路に連通されたノズルと、前記インク流路の各々に対応して設けられ、前記ノズルよりインク液を吐出させる複数の積層圧電素子より成るアクチュエータとを有するインクジェットヘッドであって、前記積層圧電素子に電極部材が配置された前記アクチュエータ、または、前記アクチュエータと電氣的に接続され、電極部材が配置された前記基板に、保持部材によって保持されている導体パタンが、半田により電氣的に接合しているインクジェットヘッドにおいて、前記圧電素子または基板の電極部材と前記保持部材の導体パタンとの接合領域を、隣接接合領域間で互いに異なるようにしたことを特徴とするインクジェットヘッド。

【請求項2】 前記接合領域の導体パタンの幅を、他の部分の導体パタンの幅よりも広くしたことを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッド。

【請求項3】 基板と、インク液を収容する複数のインク流路と、各インク流路に連通されたノズルと、前記インク流路の各々に対応して設けられ、前記ノズルよりインク液を吐出させる複数の積層圧電素子より成るアクチュエータとを有するインクジェットヘッドの製造方法において、電極部材が設けられた分割されていない積層圧電素子から成るアクチュエータ、または、前記アクチュエータと電氣的に接続され、電極部材が配置された基板と、保持部材によって保持されている導体パタンとを半田により電氣的に接合し、次いで、接合部を独立した電氣的接続にするための溝加工を行うことを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項4】 前記導体パタンは、圧電素子または基板の電極部材と重なる位置は分離せず、電極部材と重ならない位置は溝加工のピッチと同一のピッチに独立して形成してあることを特徴とする請求項3に記載のインクジェットヘッドの製造方法に使用する導体パタン。

## 【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、インクジェットヘッド及びその製造方法及びその製造方法に使用する導体パタンに関する。より詳細には、多数のインクジェットノズルを有する、いわゆるマルチノズル式のインクジェットヘッド及びその製造方法及びその製造方法に使用する導体パタンに関する。

【0002】

【従来の技術】図4は、従来のインクジェットヘッドの断面構成図で、図4(a)は縦断面図(図4(b)のA-A線断面図)、図4(b)は図4(a)のB-B線矢視拡大断面図で、図中、11は基板、12は圧電素子、13は流路板、13aはインク流路、13bは壁部、14は共通液室構成部材、14aは共通液室、15はインク供給パイプ、16はノズルプレート、16aはノズル

17は駆動回路用プリント板(PCB)、18はリード線、19は駆動電極、20は圧電素子12を区切る溝、21は保護板、22は流体抵抗部材、23、24は内部電極(ホット電極23、グラウンド電極24)、25は上部隔壁板である。

【0003】図5は、図4の駆動電極19とPCB(プリント基板)17との従来の結線(ワイヤボンディング)を示す要部拡大図で、図中、19aは圧電素子12a上の電極、19bは圧電素子の両端部電極、19cは共通電極(グラウンド)で、図示のように、各圧電素子の電極19a、19b、19cは、細いリード線18で各々に対応するPCB17上の電極に結線されている。

【0004】しかし、上記従来技術によると、ヘッド側電極及びPCB電極に金メッキを施す必要があり、費用がかかり、また、共通電極(グラウンド電極)に流れる電流は、各々の圧電素子の電極(ホット電極)に流れる電流の合計となるため、電流容量を大きくする必要がある。したがって、ワイヤボンディングを数回行うか別工程でハンダ付け等を行わなければならない、時間と費用がかかり、コストアップとなる。

【0005】図6は、特開平55-86765号公報に示されている圧電素子の電極と信号線の電極の接合例を示す図で、図中、30は圧電素子31の一方の側に配設された上部電極、31は圧電素子、32はハンダ付け部、33は選択電極、34は共通電極、35はヘッド本体、36は圧電素子31の他方の側に配設された下部電極で、図示のように、圧電素子31の上下に電極30、36を設け、上部電極30をハンダ付けにて選択電極33と接続し、下部電極36を圧力室上に配設した振動板の電極に接合するようにしたものである。

【0006】しかし、上記特開平55-86765号公報の方法では、画像品質の向上等でオリフィスの集積化が進み、圧電素子が増加された場合、ヘッド本体35上に配設される選択電極33の配置が複雑になり工程に時間がかかり、電極間の距離も短くなり、ショートする恐れもでてくる。

【0007】上記問題を解決するために、本出願人は、先に、基板上に設けられた電極パタンを各圧電素子のスリット加工と同時にパタン分離することによって、各圧電素子と外部導体との電氣的接続を行うようにしたインクジェット記録装置について提案した(特開平3-73347号公報)。

【0008】図7及び図8は、本出願人が先に提案したインクジェット記録ヘッドの一例(特開平3-73347号公報)を説明するための傾斜図、図9は、図8のA-A線断面図で、基板40は通常シリコン、セラミック、ガラス、樹脂等よりなり、電極は、通常、圧電素子駆動ICの電極との接続用電極41aと、外部リード線との接続用電極41bと、グラウンド電極用電極41cとから成り、これら電極が基板40上にパターニングされ

(3)

特開平7-156376

3

て施されている。このように、電極がパターンニングされた基板40上に、概略の位置決めによって圧電素子42を、たとえば、接着等の手段により接合する(図7)。つぎにこの圧電素子42にスリット43の加工を、たとえば、切削加工等により行う(図8)。スリット43の巾を30~40 $\mu$ m、圧電素子42の巾を80~90 $\mu$ m程度で加工することにより8本/mm程度の集積化が可能となる。これは通常のダイシングソー等により十分加工可能である。

【0009】図9は、上述のごとく、スリット43を形成した後の図で、このスリット加工によって圧電素子42が実質的に分離されるのと同時に電極パタンも分離・独立される。つまり、このとき圧電素子42と同時に基板40も一部加工することになる。また、基板40の前面(図9のM部)は、グランド電極41cを分離しないようにするため加工をしないようにする。このあとで、駆動IC44(分離した電極のパタンのピッチに合わせて電極が配置されている)をチップフローなどによって取付る(図8)。基板40の材質を適当に選択することによって、駆動IC44の放熱を十分に行うことも可能となる。

【0010】しかし、上記本出願人が先に提案したインクジェットヘッドによると、駆動ICと圧電素子とを同一基板上に搭載する場合に有効であり、もし、外部に駆動ICが有るときは、この駆動ICに結線が必要になり、前記従来技術で述べたように、ワイヤボンディング等が必要となる。

【0011】図10は、更に他の従来技術の例を説明するための断面図で、図中、1は圧電素子、2は外部電極、3は導体パタン、3aは上部支持部材、3bは下部支持部材、4は半田で、この半田4は、導体パタン3の一方の面に予め一様に施こされており、この導体パタン上の半田を各圧電素子のホット電極に重ね合せ、圧接、加熱して一括接合するものである。なお、図10(b)に接合後における図10(a)のB-B線断面図、図10(c)に接合後の図10(a)の平面図を示す。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】図10に記載の従来技術は、導体パタン3または外部電極2に施こされている半田メッキが、均一に適量の場合は、隣接接合間(電極間)で半田のはみ出しによってショートすることは無いが、メッキの量が多すぎたり、不均一であったりする場合、導体パタン3を外部電極2に接合したとき、幅方向に半田のはみ出してしまい、隣接接合間(電極間)でショートする恐れがある。本発明は、上述の如き実情に鑑みてなされたもので、特に、高密度に集積化された電氣的アクチュエータ手段から外部への電氣的接続において、加工性、組立性を向上させ、コストの低減を図ると共に、信頼性の向上に寄与するインクジェットヘッドを提供することを目的とする。

4

【0013】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解決するために、(1)基板と、インク液を収容する複数のインク流路と、各インク流路に連通されたノズルと、前記インク流路の各々に対応して設けられ、前記ノズルよりインク液を吐出させる複数の積層圧電素子より成るアクチュエータとを有するインクジェットヘッドであって、前記積層圧電素子に電極部材が配置された前記アクチュエータ、または、前記アクチュエータと電氣的に接続され、電極部材が配置された前記基板に、保持部材によって保持されている導体パタンが、半田により電氣的に接合しているインクジェットヘッドにおいて、前記圧電素子または基板の電極部材と前記保持部材の導体パタンとの接合領域を、隣接接合領域間で互いに異なるようにしたこと、更には、(2)前記接合領域の導体パタンの幅を、他の部分の導体パタンの幅よりも広くしたこと、更には、(3)基板と、インク液を収容する複数のインク流路と、各インク流路に連通されたノズルと、前記インク流路の各々に対応して設けられ、前記ノズルよりインク液を吐出させる複数の積層圧電素子より成るアクチュエータとを有するインクジェットヘッドの製造方法において、電極部材が設けられた分割されていない積層圧電素子から成るアクチュエータ、または、前記アクチュエータと電氣的に接続され、電極部材が配置された基板と、保持部材によって保持されている導体パタンとを半田により電氣的に接合し、次いで、接合部を独立した電氣的接続にするための溝加工を行うこと、更には、(4)前記導体パタンは、圧電素子または基板の電極部材と重なる位置は分離せず、電極部材と重ならない位置は溝加工のピッチと同一のピッチに独立して形成してあることを特徴としたものである。

【0014】

【作用】所定ピッチに配列された圧電素子の電極部材と、該ピッチに対応している導体パタンとを半田で接合する際に、半田接合面を隣接パタン間で異ならせることにより、パタン間の半田のはみ出しによるショートを無くす。

【0015】

【実施例】図1は、本発明の一実施例を説明するための図で、図1(a)は、図10(c)に相当する平面図、図1(b)は、図1(a)のB-B断面図で、図中、1は圧電素子の各駆動部、2は外部電極(電極部材)、3は導体パタン、3aは上カバー(保持部材)、3bは下カバー(保持部材)、4は半田で、圧電素子の各駆動部が多数一体的に形成されてアクチュエータを構成している。この実施例は、図10に示した従来技術の改良型であり、図10に示したようにして接合した時に、半田4がはみ出し隣接する電極からはみ出した半田と接触しないように、隣接する半田接合面(隣接接合領域)を、互いにずらしたものである。このように半田接合面をずら

(4)

特開平7-156376

5

すことにより、接合後の半田のはみ出しがあったとしても、隣接パタン間での半田のはみ出しによるショートがなくなり、インクジェットヘッドの信頼性が上がる。

【0016】図2は、他の実施例を説明するための図で、図2(a)は、図10(c)に相当する平面図、図2(b)は、図2(a)のB-B断面図で、この実施例は、図1で示した実施例の導体パタン3の接合部の幅を、図2(a)に破線4aにて示すように、広くとったものである。この実施例の場合、図1で示した実施例より接合面積が広いので、接合強度がよくなる。

【0017】図3は、本発明の更に他の実施例を説明するための図で、図3(a)は、図10(a)に相当する断面図、図3(b)は、図3(a)のB-B断面に相当する図で、図中、2'は内部電極、4'は内部電極2'と外部電極2とを接合している半田である。この実施例は、まだ分割されていない圧電素子1と導体パタン3とを半田接合をしてから、圧電素子1を導体パタン2ごと同時に溝加工(図3(b)中のS部と図3(a)中のd部まで)するものである。この溝加工を行う際、上カバー3a、導体パタン3、下カバー3bとから成るFPC(フレキシブル・プリント・ケーブル)3'の導体パタン3がすでに所定のピッチに分割してあれば、そのピッチに合わせて溝加工をすることにより、それぞれ独立に分断された圧電素子1の電極2を取り出すことができる。また、図3(b)に示すように、導体パタン3をベタパタン(圧電素子と接合される部分がパタン分断されておらず、一枚の板状になっている状態、図3(b)中にクロスハッチにて示す)にしておけば、溝加工時に導体パタンを破損するような心配もなく、また、一枚面のベタパタンを接合し、その後に溝加工するようにしたので、接合面積を全て接合に利用できるため、接合部の強度を向上させることにもなる。

【0018】なお、図1～図3に示した実施例では、半田メッキを使用しているが、本発明は、これに限ることではなく、異方性導電膜、導電性接着剤などを使用しても同様に適応させる。また、以上には、本発明を圧電素子とFPCの接合に適用した場合の例について説明したが、本発明は、上記実施例に限定されるものではなく、例えば、PCB等の基板から電極を取り出す場合に同様に行うことができる。

【0019】

【発明の効果】請求項1に対応する効果：半田メッキ領域が隣接パタン間で異なるので、接合時に半田がはみ出しても隣接間ショートが起きにくくなり、圧電素子の高密度化が可能で、しかも、インクジェットヘッドの信頼性を向上させることができる。

請求項2に対応する効果：半田メッキ領域のみ導体パタ

6

ン幅が広いので、パタンピッチが狭くても強い接合強度が得られ、インクジェットヘッドの信頼性が上がる。  
請求項3に対応する効果：圧電素子と導体パタンとの接合(加熱、加圧工程)後に溝加工して電極を独立分離するため、隣接パタン(電極)間には確実に分断されるので、隣接パタン間でシートが生じる心配もなく、また、パタン間のピッチを均一に溝加工できるので、インクジェットヘッドの加工性、組立性、信頼性が上がる。  
請求項4に対応する効果：導体パタンの接合部に当る導体パタン部を一枚面(分断していない)のまま圧電素子に接合するので、接合強度がより強くなり、インクジェットヘッドの組立性、信頼性が上がる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例を説明するための平面図及び断面図である。

【図2】 本発明の他の実施例を説明するための平面図及び断面図である。

【図3】 本発明の更に他の実施例を説明するための断面図及び平面図である。

【図4】 従来のインクジェットヘッドの断面図及び一部拡大断面図である。

【図5】 従来のインクジェットヘッドの圧電素子の結線を示す要部拡大図である。

【図6】 従来のインクジェットヘッドの他の例を説明する平面図である。

【図7】 従来のインクジェットヘッドの製造工程の一部を示す斜視図である。

【図8】 図7に示した工程の後工程の一部を示す斜視図である。

【図9】 図7、図8に示したインクジェット記録ヘッドの断面図(図8のA-A線断面図)である。

【図10】 従来のインクジェットヘッドの圧電素子の結線を示す他の例を示す図である。

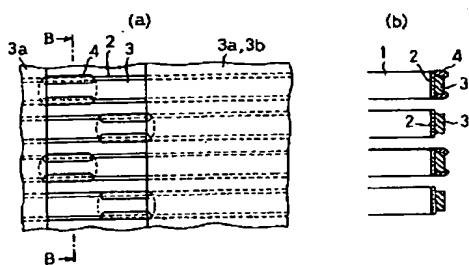
【符号の説明】

1…基板、2…外部電極、3…導体パタン、3a、3b…保持部材、4…半田、11…基板、12…圧電素子、13…流路板、13a…インク流路、13b…壁部、14…共通液室構成部材、14a…共通液室、15…インク供給パイプ、16…ノズルプレート、16a…ノズル、17…FPC、18…リード線、19…駆動電極部、19a…駆動電極、19b…両端部電極、19c…共通電極、20…溝、21…保護板、22…流体抵抗、23…ホット電極、24…グランド電極、25…上部隔壁、30…上部電極、31…圧電素子、32…ハンダ付け、33…ドット電極、34…共通電極、35…本体、36…下部電極、40…基板、41a～41c…電極、42…圧電素子、43…スリット、44…駆動IC。

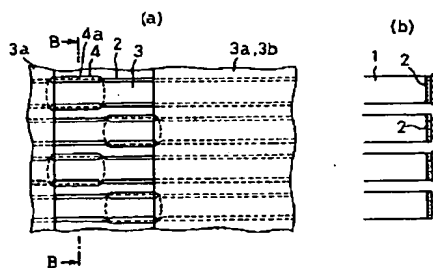
( 5 )

特開平 7 - 1 5 6 3 7 6

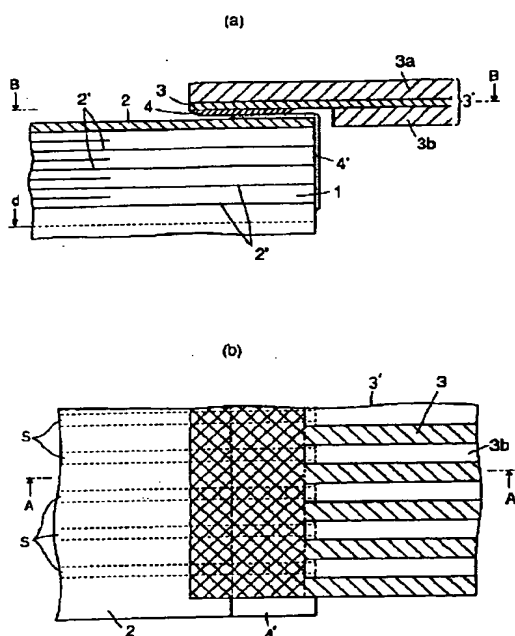
【図 1】



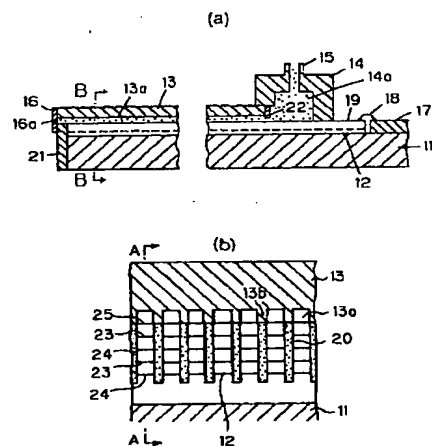
【図 2】



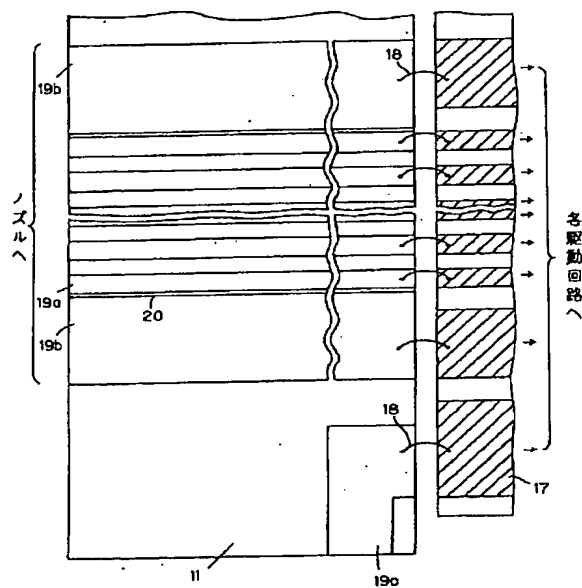
【図 3】



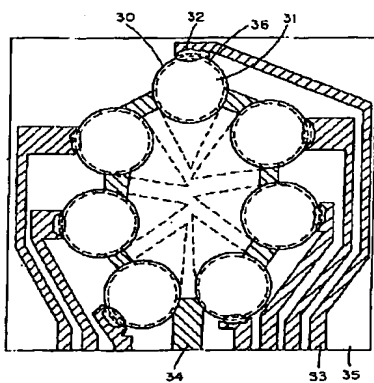
【図 4】



【図 5】



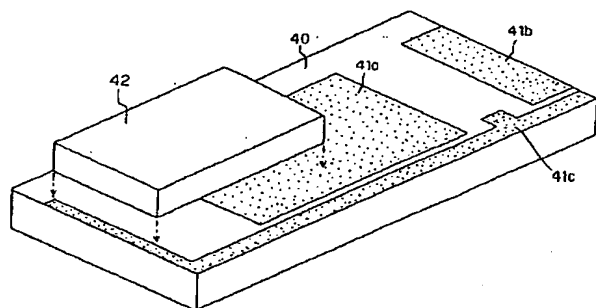
【図 6】



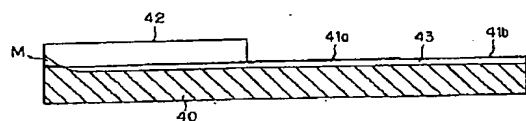
( 6 )

特開平 7 - 1 5 6 3 7 6

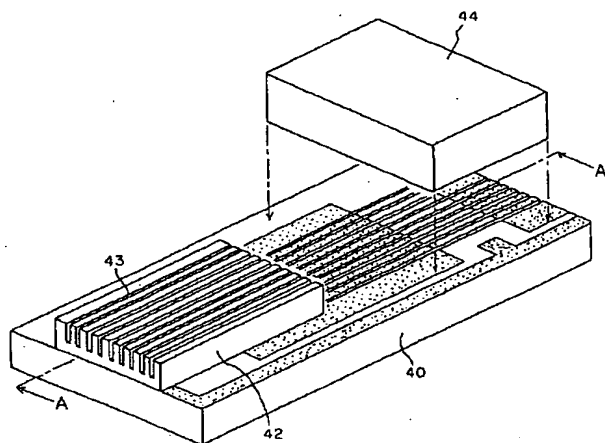
【図 7】



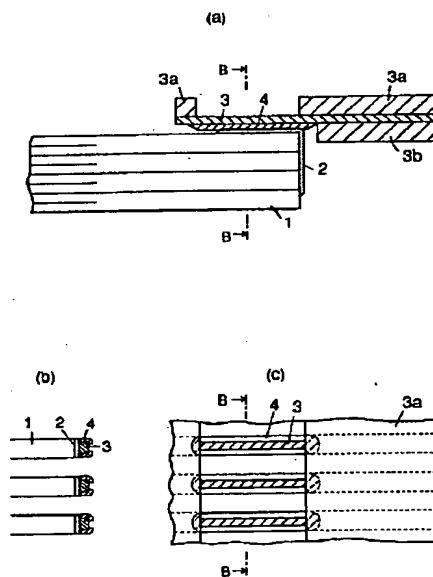
【図 9】



【図 8】



【図 10】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>  
B 4 1 J 2/16

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

B 4 1 J 3/04

1 0 3 H

**INK JET HEAD, MANUFACTURE THEREOF AND CONDUCTOR  
PATTERN USED FOR THE MANUFACTURE**

Patent Number: JP7156376  
Publication date: 1995-06-20  
Inventor(s): NAKANO TOMOAKI  
Applicant(s): RICOH CO LTD  
Requested Patent: ☐ JP7156376  
Application Number: JP19930302060 19931201  
Priority Number(s):  
IPC Classification: B41J2/01; B41J2/045; B41J2/055; B41J2/16  
EC Classification:  
Equivalents:

---

**Abstract**

---

**PURPOSE:**To eliminate a short-circuit due to extension of solder when a plurality of electrode members of a piezoelectric element is batch connected to a conductor pattern.  
**CONSTITUTION:**External electrodes 2 of a piezoelectric element 1 divided at a predetermined pitch are arranged, and a conductor pattern 3 corresponding to the electrodes 2 are solder-connected to the electrodes 2. In this case, even if solder 4 is extended, adjacent solder connecting surfaces are so deviated that extended solders of the adjacent electrodes are not brought into contact with one another.

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**



## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-156376

(43)Date of publication of application : 20.06.1995

(51)Int.Cl.

B41J 2/01  
B41J 2/045  
B41J 2/055  
B41J 2/16

(21)Application number : 05-302060

(71)Applicant : RICOH CO LTD

(22)Date of filing : 01.12.1993

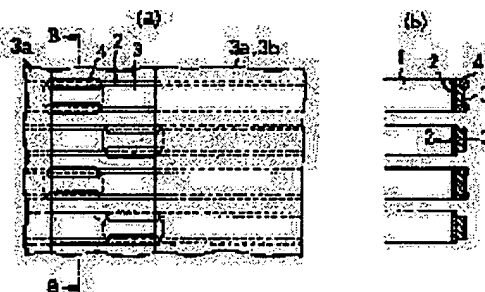
(72)Inventor : NAKANO TOMOAKI

(54) INK JET HEAD, MANUFACTURE THEREOF AND CONDUCTOR PATTERN USED FOR THE MANUFACTURE

(57)Abstract:

**PURPOSE:** To eliminate a short-circuit due to extension of solder when a plurality of electrode members of a piezoelectric element is batch connected to a conductor pattern.

**CONSTITUTION:** External electrodes 2 of a piezoelectric element 1 divided at a predetermined pitch are arranged, and a conductor pattern 3 corresponding to the electrodes 2 are solder-connected to the electrodes 2. In this case, even if solder 4 is extended, adjacent solder connecting surfaces are so deviated that extended solders of the adjacent electrodes are not brought into contact with one another.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 11.05.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection] 05.03.2002

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**\* NOTICES \***

**Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.**

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

---

**CLAIMS**

---

[Claim(s)]

[Claim 1] A substrate, two or more ink passage in which liquid ink is held, and the nozzle opened for free passage by each ink passage, It is the ink jet head which has the actuator which consists of two or more laminating piezoelectric devices which it is prepared [ piezoelectric devices ] corresponding to each of said ink passage, and make liquid ink breathe out from said nozzle. Said actuator with which the electrode member has been arranged at said laminating piezoelectric device, In the ink jet head which the pattern has joined electrically with solder or the conductor currently held by the attachment component at said substrate with which it connected with said actuator electrically, and the electrode member has been arranged -- the conductor of said piezoelectric device or the electrode member of a substrate, and said attachment component -- the ink jet head characterized by making a junction field with a pattern differ mutually between contiguity junction fields.

[Claim 2] the conductor of said junction field -- the width of face of a pattern -- the conductor of other parts -- the ink jet head according to claim 1 characterized by making it larger than the width of face of a pattern.

[Claim 3] A substrate, two or more ink passage in which liquid ink is held, and the nozzle opened for free passage by each ink passage, In the manufacture approach of an ink jet head of having the actuator which consists of two or more laminating piezoelectric devices which it is prepared [ piezoelectric devices ] corresponding to each of said ink passage, and make liquid ink breathing out from said nozzle The actuator which consists of the laminating piezoelectric device in which the electrode member was prepared, and which is not divided, A pattern is electrically joined with solder. or the substrate with which it connected with said actuator electrically, and the electrode member has been arranged and the conductor currently held by the attachment component -- subsequently The manufacture approach of the ink jet head characterized by performing recessing for making a joint into the independent electrical installation.

[Claim 4] said conductor -- the conductor used for the manufacture approach of the ink jet head according to claim 3 characterized by having formed independently in the same pitch as the pitch of recessing the location which does not separate the location where a pattern laps with a piezoelectric device or the electrode member of a substrate, and does not lap with an electrode member -- a pattern.

---

[Translation done.]

## \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## DETAILED DESCRIPTION

## [Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Industrial Application] the conductor which uses this invention for an ink jet head, its manufacture approach, and its manufacture approach -- it is related with a pattern. the conductor used for the ink jet head, its so-called manufacture approach, and its so-called manufacture approach of the multi-nozzle type which has many ink jet nozzles in a detail more -- it is related with a pattern.

[0002]

[Description of the Prior Art] Drawing 4 is the cross-section block diagram of the conventional ink jet head, drawing 4 (a) is drawing of longitudinal section (A-A line sectional view of drawing 4 (b)), and drawing 4 (b) is the B-B line view expanded sectional view of drawing 4 (a). In 11, a substrate and 12 among drawing a passage plate and 13a for a piezoelectric device and 13 Ink passage, In 13b, a wall and 14 a common liquid room and 15 for a common liquid room configuration member and 14a An ink delivery pipe, 16 a nozzle and 17 for a nozzle plate and 16a The printed circuit board for drive circuits (PCB), As for a fluid resistance member, and 23 and 24, for the slot where lead wire and 19 divide a drive electrode and, as for 20, 18 divides a piezoelectric device 12, and 21, a guard plate and 22 are [ an internal electrode (the hot electrode 23, grand electrode 24) and 25 ] up curtain boards.

[0003] Drawing 5 is the important section enlarged drawing showing the conventional connection (wirebonding) of the drive electrode 19 of drawing 4, and PCB (printed circuit board) 17, 19a is [ the both-ends electrode of a piezoelectric device and 19c of the electrode on piezoelectric-device 12a and 19b ] common electrodes (gland) among drawing, and connection of the electrodes 19a, 19b, and 19c of each piezoelectric device is carried out to the electrode on PCB 17 corresponding to each with the thin lead wire 18 like illustration.

[0004] However, according to the above-mentioned conventional technique, since the current which it is necessary to gold-plate at a head lateral electrode and a PCB electrode, and costs start, and flows to a common electrode (grand electrode) serves as the sum total of a current which flows to the electrode (hot electrode) of each piezoelectric device, it needs to enlarge current capacity. Therefore, wirebonding must be performed several times, or soldering etc. must be performed at another process, time amount and costs start, and it becomes a cost rise.

[0005] Drawing 6 is drawing showing the example of junction of the electrode of a piezoelectric device, and the electrode of a signal line shown in JP,55-86765,A. The up electrode with which 30 were arranged in one piezoelectric-device 31 side, and 31 are a piezoelectric device and the lower electrode with which a common electrode and 35 were arranged by the head body and 36 was arranged [ 32 / the soldering section and 33 ] in the another side side of a piezoelectric device 31 for a selection electrode and 34 among drawing. It is made to join to the electrode of the diaphragm which formed electrodes 30 and 36 up and down, connected the up electrode 30 with the selection electrode 33 with soldering, and arranged the lower electrode 36 on the pressure room of a piezoelectric device 31 like illustration.

[0006] However, by the approach of above-mentioned JP,55-86765,A, when integration of an orifice progresses by improvement in image quality etc. and a piezoelectric device is increased, arrangement of the selection electrode 33 arranged on the head body 35 becomes complicated, a process takes time amount, and an inter-electrode distance and a possibility of short-circuiting in short \*\*\*\* come out.

[0007] In order to solve the above-mentioned problem, these people proposed about the ink jet recording device which was made to perform electrical installation of each piezoelectric device and an outer conductor by carrying out pattern separation of the electrode pattern prepared on the substrate previously at slit processing and coincidence of each piezoelectric device (JP,3-73347,A).

[0008] An inclination Fig. for drawing 7 and drawing 8 to explain an example (JP,3-73347,A) of the ink jet recording

head which these people proposed previously, and drawing 9 With the A-A line sectional view of drawing 8, a substrate 40 usually consists of silicon, a ceramic, glass, resin, etc. an electrode Usually, it consists of electrode 41a for connection with the electrode of the piezoelectric-device drive IC, electrode 41b for connection with external lead wire, and electrode 41c for grand electrodes c, and on the substrate 40, patterning of these electrodes is carried out and they are given. Thus, an electrode joins a piezoelectric device 42 with means, such as adhesion, by positioning of an outline on the substrate 40 by which patterning was carried out ( drawing 7 ). Next, a slit 43 is processed into this piezoelectric device 42 by cutting etc. ( drawing 8 ). Eight [ // about ] integration of mm is attained by processing the width of 30-40 micrometers and a piezoelectric device 42 for the width of a slit 43 by about 80-90 micrometers. This is processible enough with the usual dicing saw etc.

[0009] Drawing 9 is drawing after forming a slit 43 like \*\*\*\*, and an electrode pattern also dissociates and becomes independent of a piezoelectric device 42 being substantially separated by this slit processing at coincidence. That is, a substrate 40 will also be processed into a piezoelectric device 42 and coincidence in part at this time. Moreover, the front face (the M section of drawing 9 ) of a substrate 40 is made not to process it in order to make it not separate grand electrode 41c. At next, it is \*\*\*\*\* ( drawing 8 ) by a chip flow etc. about drive IC 44 (the electrode is arranged according to the pitch of the pattern of the separated electrode). By choosing the quality of the material of a substrate 40 suitably, it also becomes possible to fully radiate heat in drive IC 44.

[0010] However, when it carries Drive IC and a piezoelectric device on the same substrate, it is effective, and as said conventional technique described, wirebonding etc. is needed [ connection is needed for this drive IC, and ] according to the ink jet head which these above-mentioned people proposed previously, when Drive IC is outside.

[0011] A pattern and 3a of up supporter material and 3b are [ lower supporter material and 4 ] solder. a sectional view for drawing 10 to explain the example of the conventional technique of further others -- it is -- the inside of drawing, and 1 -- a piezoelectric device and 2 -- an external electrode and 3 -- a conductor -- this solder 4 -- a conductor -- one field of a pattern 3 -- beforehand -- uniform -- \*\*\*\* -- a \*\*\*\* cage and this conductor -- they are superposition, a pressure welding, and the thing that heats and carries out package junction about the solder on a pattern at the hot electrode of each piezoelectric device. In addition, the top view of drawing 10 after junction (a) is shown in drawing 10 (b) at the B-B line sectional view of drawing 10 after junction (a), and drawing 10 (c).

[0012]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] the conventional technique given in drawing 10 -- a conductor -- in the case of optimum dose, \*\*\*\*\* solder plating in \*\*\*\* to a pattern 3 or the external electrode 2 at homogeneity the case uneven [ elapse or ] where there are many amounts of plating although it does not short-circuit by the flash of solder between contiguity junction (inter-electrode) -- a conductor -- when a pattern 3 is joined to the external electrode 2, solder overflows crosswise and there is a possibility of short-circuiting between contiguity junction (inter-electrode). It aims at offering the ink jet head which contributes to improvement in dependability while this invention was made in view of the actual condition like \*\*\*\*, raises workability and assembly nature in the electrical installation from an electric actuator means by which high density integrated especially to the exterior and aims at reduction of cost.

[0013]

[Means for Solving the Problem] Two or more ink passage in which (1) substrate and liquid ink are held in order that this invention may solve the above-mentioned technical problem, It is prepared corresponding to the nozzle opened for free passage by each ink passage and each of said ink passage. It is the ink jet head which has the actuator which consists of said nozzle from two or more laminating piezoelectric devices which make liquid ink breathe out. Said actuator with which the electrode member has been arranged at said laminating piezoelectric device, In the ink jet head which the pattern has joined electrically with solder or the conductor currently held by the attachment component at said substrate with which it connected with said actuator electrically, and the electrode member has been arranged -- the conductor of said piezoelectric device or the electrode member of a substrate, and said attachment component -- having made the junction field with a pattern differ mutually between contiguity junction fields -- further (2) -- the conductor of said junction field -- the width of face of a pattern -- the conductor of other parts -- having made it larger than the width of face of a pattern -- further (3) A substrate, two or more ink passage in which liquid ink is held, and the nozzle opened for free passage by each ink passage, In the manufacture approach of an ink jet head of having the actuator which consists of two or more laminating piezoelectric devices which it is prepared [ piezoelectric devices ] corresponding to each of said ink passage, and make liquid ink breathing out from said nozzle The actuator which consists of the laminating piezoelectric device in which the electrode member was prepared, and which is not divided, A pattern is electrically joined with solder. or the substrate with which it connected with said actuator electrically, and the electrode member has been arranged and the conductor currently held by the attachment component -- subsequently performing recessing for making a joint into the independent electrical installation -- further (4) -- said conductor -- the location

where a pattern laps with a piezoelectric device or the electrode member of a substrate is not separated, but it is characterized by having formed independently in the same pitch as the pitch of recessing the location which does not lap with an electrode member.

[0014]

[Function] the electrode member of the piezoelectric device arranged by the predetermined pitch, and the conductor corresponding to this pitch -- in case a pattern is joined with solder, the short-circuit by the solder flash between patterns is lost by changing a soldered joint side between contiguity patterns.

[0015]

[Example] Drawing 1 is drawing for explaining one example of this invention. Drawing 1 (a) The top view and drawing 1 (b) equivalent to drawing 10 (c) the B-B sectional view of drawing 1 (a) -- the inside of drawing, and 1 -- each mechanical component of a piezoelectric device, and 2 -- an external electrode (electrode member) and 3 -- a conductor -- in a pattern and 3a, a discharge ring (attachment component) and 4 are solder, a majority of each mechanical components of a piezoelectric device are formed in one, and an arm top cover (attachment component) and 3b constitute the actuator. This example is the advanced type of the conventional technique shown in drawing 10, and as it was shown in drawing 10, when it joins to it, it shifts mutually an adjoining soldered joint side (contiguity junction field) so that the solder protruded from the electrode in which solder 4 carries out flash contiguity may not be contacted. Thus, even if there is a flash of the solder after junction by shifting a soldered joint side, the short-circuit by the flash of the solder between contiguity patterns is lost, and the dependability of an ink jet head goes up.

[0016] the conductor of an example in which drawing 2 is drawing for explaining other examples, the top view with which drawing 2 (a) is equivalent to drawing 10 (c), and drawing 2 (b) are the B-B sectional views of drawing 2 (a), and this example was shown by drawing 1 -- to drawing 2 (a), the large width of face of the joint of a pattern 3 is taken, as broken-line 4a shows. Since the plane-of-composition product is larger than the example shown by drawing 1 in the case of this example, bonding strength becomes good.

[0017] Drawing 3 is drawing for explaining the example of further others of this invention, the sectional view with which drawing 3 (a) is equivalent to drawing 10 (a), and drawing 3 (b) are drawings equivalent to the B-B cross section of drawing 3 (a), and 2' is an internal electrode and solder to which 4' has joined internal electrode 2' and the external electrode 2 among drawing. the piezoelectric device 1 and conductor with which this example is not divided yet -- since a pattern 3 is joined by solder -- a piezoelectric device 1 -- a conductor -- recessing is carried out to coincidence the whole pattern 2 (to the S section in drawing 3 (b), and the d section in drawing 3 (a)). the time of performing this recessing -- arm-top-cover 3a and a conductor -- a pattern 3 and the conductor of FPC(flexible print cable)3' which consists of discharge-ring 3b -- if the pattern 3 is already divided into the predetermined pitch, the electrode 2 of the piezoelectric device 1 divided independently, respectively can be taken out by carrying out recessing according to that pitch. moreover, it is shown in drawing 3 (b) -- as -- a conductor, if the pattern 3 is used as the solid pattern (cross hatching shows in the condition that pattern fragmentation is not carried out but the part joined to a piezoelectric device has tabular [ of one sheet ], and drawing 3 (b)) the time of recessing -- a conductor -- since there is also no fear of damaging a pattern, and the solid pattern of an one-sheet side is joined, it was made to carry out recessing after that and all plane-of-composition products can be used for junction, it is also raising the reinforcement of a joint.

[0018] In addition, in the example shown in drawing 1 - drawing 3, although solder plating is used, even if it does not restrict this invention to this and the anisotropy electric conduction film, electroconductive glue, etc. are used for it, it is fitted similarly. Moreover, although the example at the time of applying this invention to junction of a piezoelectric device and FPC was explained above, this invention can be similarly performed by what is limited to the above-mentioned example, for example, when picking out an electrode from substrates, such as PCB.

[0019]

[Effect of the Invention] Effectiveness corresponding to claim 1: Since solder plating fields differ between contiguity patterns, even if solder overflows at the time of junction, the short-circuit between contiguity stops being able to occur easily, the densification of a piezoelectric device can be possible and, moreover, the dependability of an ink jet head can be raised.

the effectiveness:solder plating field corresponding to claim 2 -- a conductor -- since pattern width of face is wide, even if a pattern pitch is narrow, strong bonding strength is obtained, and the dependability of an ink jet head goes up.

the effectiveness:piezoelectric device and conductor corresponding to claim 3 -- since recessing is carried out after junction (heating, pressurization process) to a pattern, an electrode is gained separate independence, there is also no fear of a sheet arising between contiguity patterns since it is certainly divided between contiguity patterns (electrode) and recessing of the pitch between patterns can be carried out to homogeneity, the workability of an ink jet head, assembly nature, and dependability go up.

effectiveness: corresponding to claim 4 -- a conductor -- the conductor which is equivalent to the joint of a pattern -- since the pattern section is joined to a piezoelectric device with an one-sheet side (it has not divided), bonding strength becomes stronger and the assembly nature of an ink jet head and dependability go up.

---

[Translation done.]

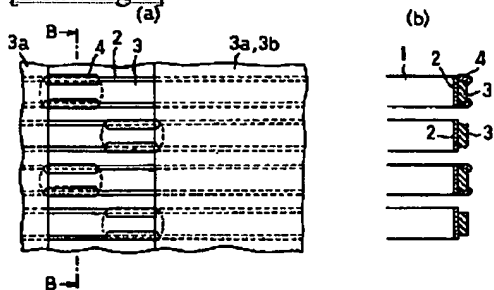
## \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

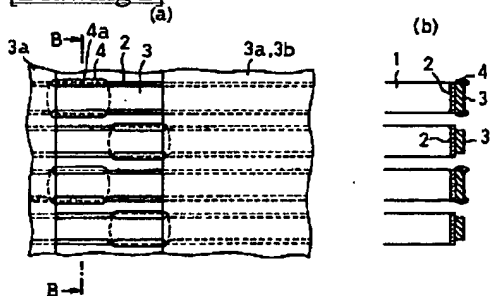
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## DRAWINGS

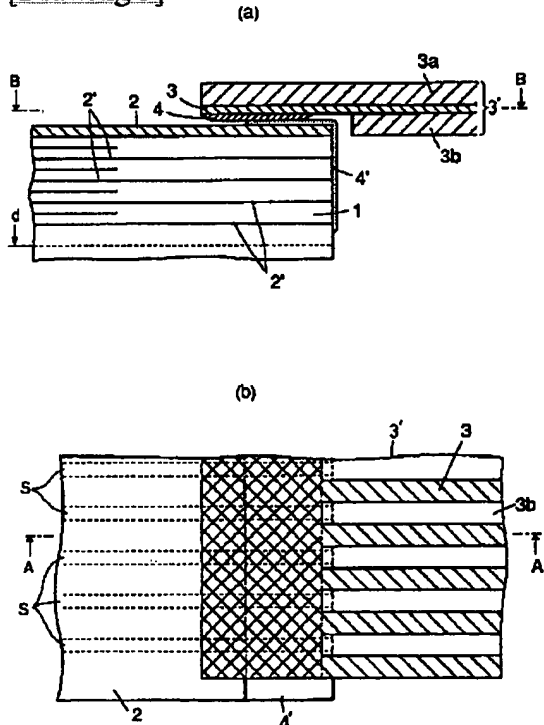
[Drawing 1]



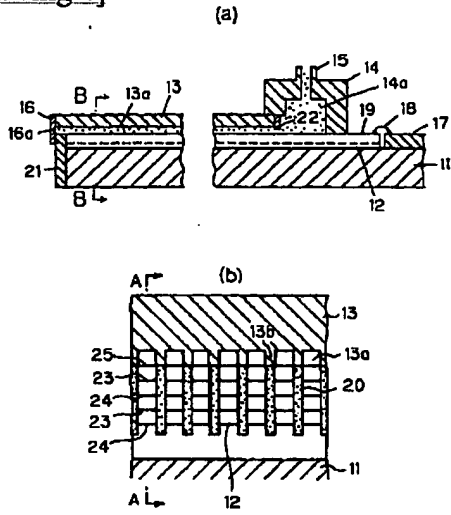
[Drawing 2]



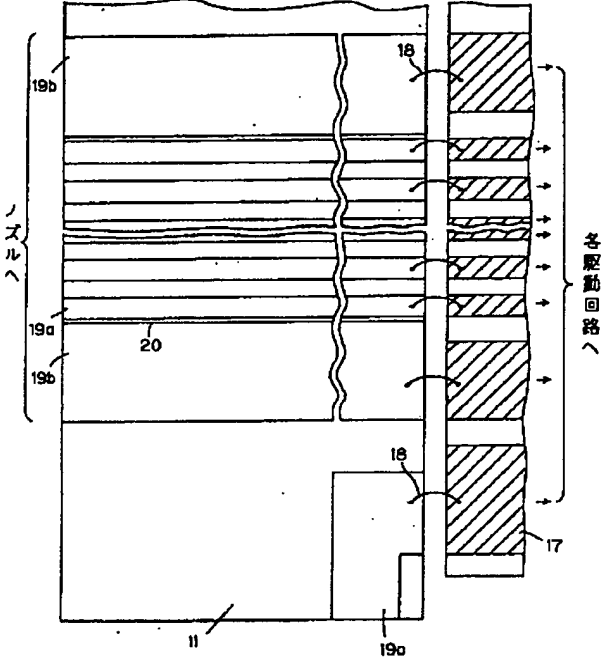
[Drawing 3]



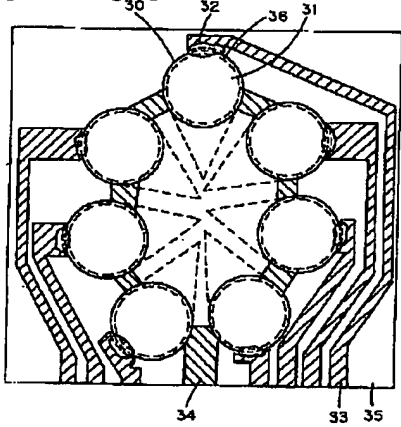
[Drawing 4]



[Drawing 5]

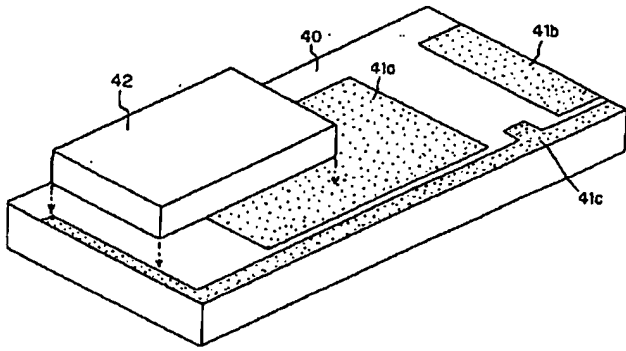


[Drawing 6]

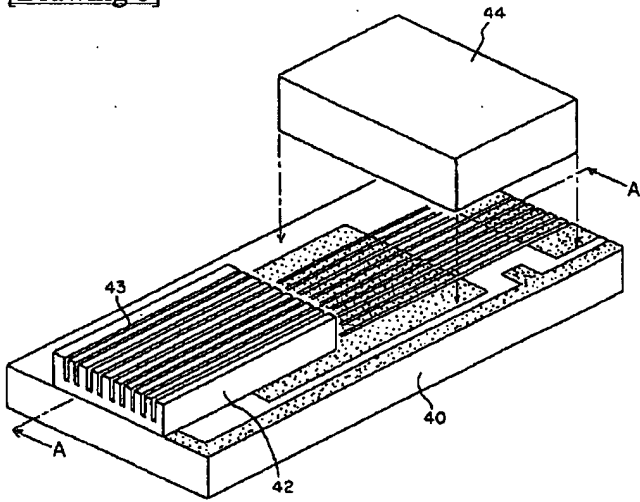


[Drawing 7]

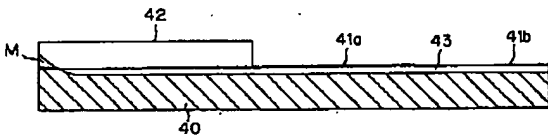




[Drawing 8]

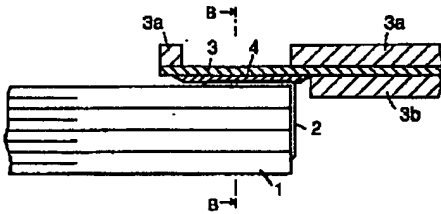


[Drawing 9]

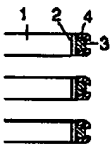


[Drawing 10]

(a)



(b)



(c)

